

陶瓷电路板 陶瓷基板 导热快 陶瓷COB电路

产品名称	陶瓷电路板 陶瓷基板 导热快 陶瓷COB电路
公司名称	上海卡贝尼精密陶瓷有限公司
价格	10.00/个
规格参数	加工定制:是 特性:半导体陶瓷 功能:绝缘装置陶瓷
公司地址	上海浦东界龙大道598号
联系电话	021-68393689-8198 13681924213

产品详情

成型

氧化锆陶瓷的成型有干压成型、等静压成型、注浆成型、热压铸成型、流延成型、注射成型、塑性挤压成型、胶态凝固成型等。其中使用最广泛的是注塑与干压成型。

(1) 注浆成型

注浆成型的成型过程包括物理脱水过程和化学凝聚过程，物理脱水通过多孔的石膏模的毛细作用排除浆料中的水分，化学凝聚过程是因为在石膏模表面 $CaSO_4$ 的溶解生成的 Ca^{2+} 提高了浆料中的离子强度，造成浆料的絮凝。在物理脱水和化学凝聚的作用下，陶瓷粉体颗粒在石膏模壁上沉积成型。注浆成型适合制备形状复杂的大型陶瓷部件，但坯体质量，包括外形、密度、强度等都较差，工人劳动强度大且不适合自动化作业。

(2) 热压铸成型

热压铸成型是在较高温度下（60~100℃）使陶瓷粉体与粘结剂（石蜡）混合，获得热压铸用的料浆，浆料在压缩空气的作用下注入金属模具，保压冷却，脱模得到蜡坯，蜡坯在惰性粉料保护下脱蜡后得到素坯，素坯再经高温烧结成瓷。热压铸成型的生坯尺寸精确，内部结构均匀，模具磨损较小，生产效率高，适合各种原料。蜡浆和模具的温度需严格控制，否则会引起欠注或变形，因此不适合用来制造大型部件，同时两步烧成工艺较为复杂，能耗较高。

(3) 流延成型

流延成型是把陶瓷粉料与大量的有机粘结剂、增塑剂、分散剂等充分混合，得到可以流动的粘稠浆料，把浆料加入流延机的料斗，用刮刀控制厚度，经加料嘴向传送带流出，烘干后得到膜坯。此工艺适合制备薄膜材料，为了获得较好的柔韧性而加入大量的有机物，要求严格控制工艺参数，否则易造成起皮、条纹、薄膜强度低或不易剥离等缺陷。所用的有机物有毒性，会产生环境污染，应尽可能采用无毒或少

毒体系，减少环境污染。[1]

脱脂排胶除了以干压为基础的成型技术外，其它工艺成型的产品都要进行脱脂排胶处理后方可入炉烧结，因为除干压成型外的其它工艺会在成型时在锆粉里加入一定比例的塑化剂，这些塑化剂在产品成型后就必须去除，不然会对烧结出的产品造成严重的品质影响。塑化剂主要为石蜡及其它高分子材料所构成，要求这些材料在一定温度下表现出具有很好的塑性与流动性，常温下则要有一定的韧性及强度。

烧结氧化锆陶瓷可采用的烧结方法通常有：无压烧结，热压烧结和反应热压烧结，热等静压烧结（hip），微波烧结，超高压烧结，放电等离子体烧结（sps），原位加压成型烧结等。常以无压烧结为主。

本产品的加工定制是是，特性是半导体陶瓷，功能是绝缘装置陶瓷，微观结构是单晶与玻璃相，品牌是卡贝尼